Best Available Copy

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

06-017237

(43)Date of publication of application: 25.01.1994

(51)Int.CI.

C23C 14/28

(21)Application number: 04-199215 (71)Applicant: TOYOTA MOTOR CORP

TOYOTA CENTRAL RES &

DEV LAB INC

TOYOTA AUTOM LOOM

WORKS LTD

(22)Date of filing:

01.07.1992

(72)Inventor: TAKAYANAGI NOBORU

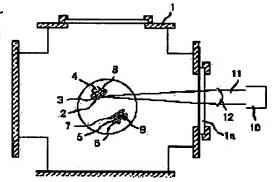
INUZUKA HIROYUKI TAGA YASUNORI

TAGA YASUNORI OWAKI TAKESHI YAMADERA HIDEYA AKIHAMA KAZUHIRO

(54) FILM FORMATION BY LASER

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a dense film having a smaller inclusion amt. of droplets on a substrate by controlling an incident angle at the time of irradiating a material to be irradiated with a laser beam, thereby suppressing the generation of the droplets from the material to be irradiated. CONSTITUTION: The material 2 which is to be irradiated and consists of the metal disposed in a reduced pressure vessel 1 is irradiated with the laser beam 1, by that, evaporated particles are released therefrom. The generation of the droplets (fine particulates which are not electrified) from the material 2 to be irradiated is suppressed by setting the incident angle of the laser beam 1 at ≤43° at this time. The evaporated particles mentioned above are



deposited by evaporation on a base material 5 disposed to face the material 2 to be irradiated. The inclusion amt. of the droplets is thus decreased and the dense magnetic thin film and conductor thin film having the excellent magnetic characteristics and conductive characteristics are obtd.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-17237

(43)公開日 平成6年(1994)1月25日

(51)Int.Cl.⁵

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

C 2 3 C 14/28

9271-4K

審査請求 未請求 請求項の数1(全 15 頁)

(21)出願番号

特願平4-199215

(22)出願日

平成4年(1992)7月1日

(71)出願人 000003207

トヨタ自動車株式会社

愛知県豊田市トヨタ町1番地

(71)出願人 000003609

株式会社豊田中央研究所

愛知県愛知郡長久手町大字長湫字横道41番

地の1

(71)出願人 000003218

株式会社豊田自動織機製作所

愛知県刈谷市豊田町2丁目1番地

(74)代理人 弁理士 大川 宏

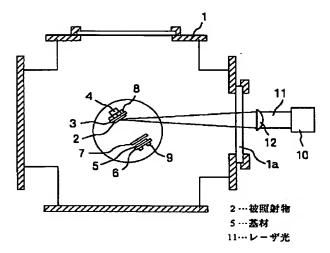
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 レーザ成膜方法

(57) 【要約】

【目的】レーザ光を被照射物に照射する際の入射角を制 御して、被照射物からのドロップレットの発生を抑制す る。

【構成】金属よりなる被照射物2に入射角43度以下で レーザ光11を照射する。被照射物表面における衝撃波 の生成が抑制され、この結果ドロップレットの発生が抑 制される。基板5の上にドロップレットの混入量の少な い緻密な膜を成膜することが可能となる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 減圧容器内に配された被照射物にレーザ 光を集光、照射して蒸発粒子を放出させ、該蒸発粒子を 該被照射物に対向配設された基材上に蒸着させるレーザ 成膜方法において、

前記被照射物が金属よりなり、該被照射物に入射角43 度以下でレーザ光を照射することを特徴とするレーザ成 膜方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、レーザ光を利用して金 属薄膜を形成するレーザ成膜方法に関する。

[0002]

【従来の技術】従来より、導電体薄膜、誘電体薄膜、半導体薄膜、超電導体薄膜及び磁性薄膜などを形成する方法として、イオンプレーティング法やイオンビーム法などが一般的に知られている。これらの方法は、アルゴンなどの不活性ガスのガスプラズマや放電により、基材に蒸着させる粒子の蒸発やイオン化が行われる。このため、これらの方法では、成膜される基材表面を洗浄して密着性の向上を図ったり、膜の結晶性などの物性制御などを効果的に行うことができるものの、不活性ガスの不純物が膜中に混入しやすい。

【0003】また、近年においては、特開昭59-116373号公報などに開示されているように、真空中に配設した被照射物にレーザ光を集光、照射して被照射物を蒸発させ、この蒸発粒子を基材上に蒸着させるレーザ成膜法も知られている。このレーザ成膜法は、集光されたレーザ光が有する高密度エネルギーにより、高真空下で蒸発粒子の蒸発が行われる。このため、上記イオンプレーティング法やイオンビーム法などと比較して、膜中への不活性ガスなどの不純物の混入を格段と減少させることができる。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかし、上記レーザ成膜法においては、帯電していない微粒子(以下、ドロップレットという)の膜中混入が極めて大きな問題となっている。すなわち、ドロップレットの粒径は1μmから数10μmに及び、このドロップレットが膜中に混入すると、膜の表面形態、特に平滑性が著しく劣化するとともに、膜密度も低下する。また、導電体薄膜や磁性薄膜などにドロップレットが混入すると、導電特性や磁気特性などの物性が著しく劣化する。

【0005】例えば、Fe-Si-B膜におけるドロップレットの平均混入密度と膜密度との関係を図43に示す。図43よりドロップレットの平均混入密度が 10^5 個//cm 2 である膜の密度は6.0g/cm 3 であり、これはバルク値(7.2g/cm 3)の約83%にしか相当せず、ポーラスな膜であることがわかる。またこの膜の保磁力は13(Oe)となり、例えばこの膜をトル

クセンサーに適用した場合には、センサー感度が劣ることがわかる。一方、ドロップレットの平均混入密度が 2×10^3 個 $/ \text{cm}^2$ である膜の密度は $7.0 \text{ g}/ \text{cm}^3$ となり、これはバルク値の 9.7 %に相当し、バルクなみの緻密な膜であることがわかる。このため、膜の保磁力も 5.00 まで低下し、ドロップレットの平均混入密度が 1.05 個 $/ \text{cm}^2$ である膜よりも 6.2 %も保磁力を低減することができる。

【0006】このようなドロップレットの膜中混入を阻 止するものとして、例えばJ. Vac. Sci. Tec hnol. B3 (4), Jul/Aug 1985, A merican Vacuum Societyに開示 された装置がある。これは、イオン、中性粒子、クラス タ、ドロップレットの各蒸発粒子の速度差を利用してド ロップレットの膜中混入を阻止するものである。上記蒸 発粒子を速度の大きい順に並べると、イオン、中性粒 子、クラスタ、ドロップレットの順となる。上記装置で は、遅延回路により開閉可能に制御されたシャッターが 被照射物及び基材間に設置されている。この遅延回路に は、パルスレーザの照射時刻からの遅延時刻が設定され る。そして、パルスレーザの照射後所定時間だけ開口し てイオン、中性粒子及びクラスタを通過させ、その後閉 口してドロップレットを通過させないように上記遅延回 路の遅延時刻を所定の値に設定することにより、ドロッ プレットの膜中混入が阻止される。

【0007】上記装置では、レーザ照射後の遅延時刻を短くするほど、ドロップレットの平均混入密度を低減することができる。しかし一方では、遅延時刻を短くしすぎるとイオン、中性粒子、クラスタまでをも基材上へ到達させないことになり、この結果成膜速度が低下するという問題がある。また、蒸発粒子の速度はイオン、中性粒子、クラスタ、ドロップレットの順に小さくなるが、これは平均的にみた場合の傾向であり、それぞれの粒子群は広範な速度分布を有しており、実際にはこのような単純な線引きを行なうことができない。このため、蒸発粒子の速度差を利用した上記装置では、ドロップレットの混入量を十分に低減することができない。例えば、上記文献(J. Vac. Sci. Technol. B3

(4). Jul/Aug 1985. American Vacuum Society)には、シャッターを使用することによりドロップレットの平均混入密度を106個/cm² (シャッター未使用時のドロップレットの平均混入密度)から105個/cm² まで低減させ得る旨記載されているが、この膜でも十分に緻密な膜とはいえない。

【0008】したがって、上記従来の装置のように、機械的・電気的手法により被照射物から放出されたドロップレットが基材に到達するのを阻止することにより、ドロップレットの膜中混入を阻止するという方法には限界がある。そこで、本発明者は、レーザ照射の仕方により

被照射物からドロップレットを発生させないという方向 へ発想を転換し、レーザ照射の仕方と被照射物からのド ロップレットの発生との関係について検討した。

【0009】なお、Laser Ablation for Materials Synthesis, vol. 191. Material Reserch Society, symposium proceedingsには、レーザ光を被照射物に照射させる際の入射角と、被照射物からのドロップレットの発生との関係に対けて検討した結果が開示されている。これは超電導体対対に緩射した結果が開示されている。これは超電導体対対に照射するときの入射角を小さくするほど、被照射物からドロップレットが発生しやすい旨記載されている。このため、従来においては、レーザ光を被照射物に照射する際の入射角を45度以上に設定することにより、被照射物からのドロップレットの発生を効果的に抑えることができると認識されていた。

【 O O 1 O 】しかし、金属薄膜をレーザ成膜法により形成する場合について、本発明者が試みた結果、レーザ光を被照射物に照射する際の入射角を45度以上に設定しても被照射物からのドロップレットの発生を抑制することができなかった。本発明は上記実情に鑑みてなされたものであり、金属薄膜をレーザ成膜法により形成する際、レーザ光を被照射物に照射する時の入射角を制御することにより被照射物からのドロップレット発生を防止して、ドロップレットの膜中混入を効果的に阻止することを目的とする。

[0011]

【課題を解決するための手段】本発明者は、金属と酸化物等の非金属とでは、融点、熱伝導率等の諸物性が大きく異なり、ドロップレットの抑制に最適の入射角が異なるという推定の下、鋭意研究した。そして上記入射角を種々変化させ、ドロップレットの発生と入射角との関係を調べ、本発明を完成した。すなわち、本発明は、減圧容器内に配された被照射物にレーザ光を集光、照射して蒸発粒子を放出させ、該蒸発粒子を該被照射物に対向配設された基材上に蒸着させるレーザ成膜方法において、前記被照射物が金属よりなり、該被照射物に入射角43度以下でレーザ光を照射することを特徴とする。

【 O O 1 2 】ここで、入射角とは、被照射物表面に入射 するレーザ光の中心の光軸が、被照射物表面の法線とな す角をいう。

[0013]

【作用】本発明のレーザ成膜法では、金属よりなる被照射物にレーザ光を照射する際の入射角を43度以下に設定することにより、被照射物からのドロップレットの発生を効果的に抑制することができ、その結果成膜された膜中のドロップレットの平均混入密度を低減することが可能となる。

【0014】尚、ドロップレットの抑制効果は、レーザパワー密度の変化によるものではない。これは以下の様に説明される。レーザ入射角を一定にし、レンズ調整することによって、レーザパワー密度を変化させてドロップレットの発生量を調べて見ると、パワー密度の増大に伴い、ドロップレット発生量が増大した。一方、入射角を低角にする場合レーザパワー密度は増大するが、本発明の通りドロップレットは急激に減少した。

[0015]

【実施例】以下、実施例により本発明を具体的に説明す る。まず、本実施例に用いたレーザ成膜装置について、 図1を参照しつつ説明する。耐圧容器よりなり所定の減 圧状態に維持可能な真空チャンパ1内には、被照射物2 を保持する被照射物ホルダ3がモータ4の駆動により回 転可能に設置されている。なお、被照射物ホルダ3はモ ータ4とともに揺動可能とされ、後述するレーザ光の入 射角を変更できるようにされている。また真空チャンパ 1内の被照射物ホルダ3に対向する位置には、基材5を 保持する基材ホルダ6が可動シャッタフを介して配設さ れている。この可動シャッタフは、後述するレーザ発振 器を作動させてからレーザ光が安定するまで、つまり被 照射物から放出される蒸発粒子が安定するまで閉鎖され ることにより、安定した膜を得るためのものである。な お、被照射物ホルダ3に保持される被照射物2をアース にとり、基材ホルダ6に保持される基材5にパイアス電 圧を印加することにより、放出物中の荷電粒子の速度を 制御して、成膜速度を制御できるようになっている。ま た、被照射物ホルダ3、基材ホルダ6には、ヒータ8、 9がそれぞれ付設されており、被照射物2及び基材5を 所望の温度に制御できるようになっている。

【0016】レーザ発振器10は所定のレーザ光11を 射出するもので、このレーザ光11は集光レンズ(石英 レンズ)12を通過した後、真空チャンバ1の側面に配 設された石英窓1aを介して真空チャンバ1内に導入さ れる。なお、集光レンズ12における焦点距離の調整に よって、被照射物2に照射されるレーザ光11のレーザ パワー密度を調整することができる。

【0017】(実施例1)上記レーザ成膜装置を用いて、Ni薄膜を形成した。被照射物2にNi(融点1453°C)、基材5にSiウエハを用い、レーザ光11にはKrFエキシマレーザ(波長248nm、パルスエネルギー250mJ)を用い、成膜中の真空チャンパー1内圧力は1×10 $^{-6}$ Torr以下、被照射物2上でのレーザパワー密度は7J $^{\prime}$ cm $^{\prime}$ 、被照射物2と基材5間の距離は25mm、基材5のパイアス電圧は0 $^{\prime}$ 、モータ4の回転速度50rpm、被照射物2及び基材5の温度は空温、照射パルス数は膜厚が2 $^{\prime}$ μmになるように設定し、レーザ光11の入射角 $^{\prime}$ を10度、20度、30度、38度、45度と変更して、それぞれNi薄膜を成

膜した。なお入射角 θ は、図2に示すように、被照射物2表面に入射するレーザ光11の中心の光軸Cが、被照射物2表面の法線となす角とする。

【0018】各入射角 θ で成膜したNi薄膜について、ドロップレットの平均混入密度をSEM写真より算出した。その結果を図3に示す。図3からも明らかなように、入射角 θ を小さくするほどドロップレットの平均混入密度を低減することができる。また、入射角 θ を30度以下にして成膜したNi薄膜は、ドロップレットの平均混入密度が2×103個/cm²以下となった。ドロップレットの平均混入密度が2×103個/cm²のNi薄膜は、膜密度が8.5g/cm³であり、バルク値(8.9g/cm³)の95%に相当する緻密な関である。このため、バルク値の95%以上の密度を有する緻密なNi薄膜を成膜するには、入射角 θ を30度以下に設定すればよいことがわかる。

【0019】また、入射角 θ を45度、30度、20度 として成膜したNi薄膜の表面形態を観察した。各Ni 薄膜表面の粒子構造を示すSEM写真を図4~図 θ Cに示 す。図4は入射角 θ を45度としたときのNi薄膜の表 面形態を示し、(a)は200倍の θ SEM写真で、

(b) は2000倍のSEM写真である。図5は入射角 θ を30度としたときのNi薄膜の表面形態を示し、

(a) は200倍のSEM写真で、(b) は2000倍のSEM写真である。図6は入射角 θ を20度としたときのNi薄膜の表面形態を示し、(a) は200倍のSEM写真で、(b) は200倍のSEM写真で、(c) は200倍のSEM写真で、んかは200倍のSEM写真である。【0020】これらの図からも明らかなように、入射角 θ を45度として成膜したNi薄膜にはドロップレットの混入が観察された(図4参照)のに対し、入射角 θ での混入がほとんど観察されなかった(図5、図6と、ットの混入がほとんど観察されなかった(図5、図6として成膜したときの、レーザ照射後の被照射物(Ni)2の表面形態を観察した。各被照射物(Ni)2の表面形態を研究を観察したときの被照射物(Ni)2の表面形態を示すSEM写真を図7~図9に示す。図7は入射角 θ を45度としたときの被照射物(Ni)2の表面形態を示し、(a)は200倍のSEM写真で、

(b) は2000倍のSEM写真である。図8は入射角 θ を30度としたときの被照射物(Ni)2の表面形態を示し、(a) は200倍のSEM写真で、(b) は200倍のSEM写真である。図9は入射角 θ を20度としたときの被照射物(Ni)2の表面形態を示し、

(a) は200倍のSEM写真で、(b) は2000倍のSEM写真である。

【 0021】これらの図からも明らかなように、入射角 θ を 45度としてレーザ照射した被照射物(N i) 2 の 表面には i ロップレット発生に起因すると考えられる波 状構造が観察された(図 7 参照)のに対し、入射角 θ を 3 0度、 2 0度としてレーザ照射した被照射物(N i)

2の表面には波状構造が観察されなかった(図8、図9 参照)。すなわち、レーザ照射した被照射物(Ni)2 の表面に生成される波状構造は、入射角 θ を小さくするほど生成されにくくなり、ある臨界角度(この場合は3 0度)で消失することがわかる。また、この臨界角度を挟んでドロップレットの混入量には大きな差が認められ、臨界角度以下ではドロップレットの混入量が激減することが認められる。

【0022】以上のことより、ドロップレットの発生には、レーザ照射により被照射物 2の表面に生成される波状構造が起因していることがわかる。そして、この波状構造を完全に消失させることによって、即ち入射角 θ を制御し、ある臨界角度以下に設定することによって、ドロップレットの混入のない緻密な膜形成が可能になると考えられる。

【0023】(実施例2)被照射物2にFe(融点1536℃)を用いること以外は上記実施例1と同様の条件でFe薄膜を形成した。各入射角 θ で成膜したFe薄膜について、実施例1と同様にドロップレットの平均混入密度を測定した。その結果を図10に示す。図10からも明らかなように、入射角 θ を32度以下にすることにより、ドロップレットの平均混入密度が2×103個/cm²のFe薄膜は、原本では、が7.5g/cm³であり、バルク値(7.87g/cm³)の95%に相当する緻密な膜である。このため、バルク値の95%以上の密度を有する緻密なFe薄膜を成膜するには、入射角 θ を32度以下に設定すればよいことがわかる。

【0024】また、入射角 θ を45度、30度、20度として成膜したFe薄膜の表面形態を観察した。各Fe薄膜表面の粒子構造を示すSEM写真を図11~図13に示す。図11は入射角 θ を45度としたときのFe薄膜の表面形態を示し、(a)は200倍のSEM写真で、(b)は200倍のSEM写真で、(b)は200倍のSEM写真で、(b)は200倍のSEM写真である。図13は入射角 θ を20度としたときのFe薄膜の表面形態を示し、(a)は200倍のSEM写真である。図13は入射角 θ を20度としたときのFe薄膜の表面形態を示し、(a)は200倍のSEM写真で、(b)は200倍のSEM写真である。

【0025】さらに、入射角 θ を45度、30度、20度として成膜したときの、レーザ照射後の被照射物(Fe)2の表面形態を観察した。各被照射物(Fe)2の表面の粒子構造を示すSEM写真を図14~図16に示す。図14は入射角 θ を45度としたときの被照射物(Fe)2の表面形態を示し、(a)は200倍のSEM写真で、(b)は200倍のSEM写真である。図15は入射角 θ を30度としたときの被照射物(Fe)2の表面形態を示し、(a)は200倍のSEM写真

で、(b)は2000倍のSEM写真である。図16は 入射角 θ を20度としたときの被照射物(Fe)2の表 面形態を示し、(a)は200倍のSEM写真で、

(b)は2000倍のSEM写真である。

【0026】(実施例3)被照射物2にCr(融点1875℃)を用いること以外は上記実施例1と同様の条件でCr薄膜を形成した。各入射角 θ で成膜したCr薄膜について、実施例1と同様にドロップレットの平均混入密度を測定した。その結果を図17に示す。図17からも明らかなように、入射角 θ を33度以下にすることにより、ドロップレットの平均混入密度が2×103個/cm²以下となることがわかる。ドロップレットの平均混入密度が2×103個/cm²のCr薄膜は、原が6.8g/cm³であり、パルク値(7.19g/cm³)の95%に相当する緻密な膜である。このため、パルク値の95%以上の密度を有する緻密なCr薄膜を成膜するには、入射角 θ を33度以下に設定すればよいことがわかる。

【0027】また、入射角 θ を45度、30度、20度として成膜したCr薄膜の表面形態を観察した。各Cr薄膜表面の粒子構造を示すSEM写真を図18~図20に示す。図18は入射角 θ を45度としたときのCr薄膜の表面形態を示し、(a)は200倍のSEM写真で、(b)は200倍のSEM写真である。図19は入射角 θ を30度としたときのCr薄膜の表面形態を示し、(a)は200倍のSEM写真で、(b)は2000倍のSEM写真である。図20は入射角 θ を20度としたときのCr薄膜の表面形態を示し、(a)は200倍のSEM写真である。図20は入射角 θ を20度としたときのCr薄膜の表面形態を示し、(a)は200倍のSEM写真で、(b)は2000倍のSEM写真である。

【0028】さらに、入射角 θ を45度、30度、20度として成膜したときの、レーザ照射後の被照射物(Cr)2の表面形態を観察した。各被照射物(Cr)2の表面の粒子構造を示すSEM写真を図21~図23に示す。図21は入射角 θ を45度としたときの被照射物(Cr)2の表面形態を示し、(a)は200倍のSEM写真で、(b)は2000倍のSEM写真である。図22は入射角 θ を30度としたときの被照射物(Cr)2の表面形態を示し、(a)は2006のSEM写真で、(b)は2006のSEM写真である。図23は入射角 θ を20度としたときの被照射物(Cr)2の表面形態を示し、(a)は2006のSEM写真で、

(b) は2000倍のSEM写真である。

【0029】(実施例4)被照射物2にMo(融点2610~)を用いるとともに、入射角 θ を20度、30度、45度、52度、60度とすること以外は上記実施例1と同様の条件でMo薄膜を形成した。各入射角 θ で成膜したMo 薄膜について、実施例1と同様にドロップレットの平均混入密度を測定した。その結果を図24に示す。図24からも明らかなように、入射角 θ を43度

以下にすることにより、ドロップレットの平均混入密度 $m^2 \times 10^3$ 個 $/ cm^2$ 以下となることがわかる。ドロップレットの平均混入密度が 2×10^3 個 $/ cm^2$ の m^3 であり、バルク値($10.22g/cm^3$)の95%に相当する緻密な膜である。このため、バルク値の95%以上の密度を有する緻密な m^3 関を成膜するには、入射角6 を43 度以下に設定すればよいことがわかる。

【0030】また、入射角 θ を60度、45度、30度として成膜したMo薄膜の表面形態を観察した。各Mo薄膜表面の粒子構造を示すSEM写真を図25~図27に示す。図25は入射角 θ を60度としたときのMo薄膜の表面形態を示し、(a)は200倍のSEM写真で、(b)は200倍のSEM写真で、(b)は200倍のSEM写真で、(b)は200倍のSEM写真である。図27は入射角 θ を30度としたときのMo薄膜の表面形態を示し、(a)は200倍のSEM写真で、(b)は200倍のSEM写真で、(b)は200倍のSEM写真である。

【0031】さらに、入射角 θ を60度、45度、30度として成膜したときの、レーザ照射後の被照射物(Mo)2の表面形態を観察した。各被照射物(Mo)2の表面の粒子構造を示すSEM写真を図28~図30に示す。図28は入射角 θ を60度としたときの被照射物(Mo)2の表面形態を示し、(a)は200倍のSEM写真で、(b)は200倍のSEM写真である。図29は入射角 θ を45度としたときの被照射物(Mo)2の表面形態を示し、(a)は200倍のSEM写真で、(b)は200倍のSEM写真である。図30は入射角 θ を30度としたときの被照射物(Mo)2の表面形態を示し、(a)は200倍のSEM写真で、

(b) は2000倍のSEM写真である。

【0032】(実施例5)被照射物2にW(融点3410°C)を用いるとともに、入射角 θ を20度、30度、45度、52度、60度とすること以外は上記実施例1と同様の条件でW薄膜を形成した。各入射角 θ で成膜したW薄膜について、実施例1と同様にドロップレットの平均混入密度を測定した。その結果を図31に示す。図31からも明らかなように、入射角 θ を43度以下により、ドロップレットの平均混入密度が2×103個/cm²以下となることがわかる。ドロップレットの平均混入密度が2×103個/cm²のW薄膜は、103個/cm²のW薄膜は、103個/cm³であり、バルク値(19.3g/cm³)の95%に相当する緻密な膜である。このため、バルク値の95%以上の密度を有する緻密なW薄膜を成膜するには、入射角 θ を43度以下に設定すればよいことがわかる。

【0033】また、入射角 θ を60度、45度、30度 として成膜したW薄膜の表面形態を観察した。各W薄膜 表面の粒子構造を示すSEM写真を図32~図34に示す。図32は入射角 θ を60度としたときのW薄膜の表面形態を示し、(a)は200倍のSEM写真で、

(b) は2000倍のSEM写真である。図33は入射 角 θ を45度としたときのW薄膜の表面形態を示し、

(a) は200倍のSEM写真で、(b) は2000倍のSEM写真である。図34は入射角 θ を30度としたときのW薄膜の表面形態を示し、(a) は200倍のSEM写真で、(b) は2000倍のSEM写真である。【0034】さらに、入射角 θ を60度、45度、30度として成膜したときの、レーザ照射後の被照射物

(W) 2の表面形態を観察した。各被照射物 (W) 2の表面の粒子構造を示すSEM写真を図35~図37に示す。図35は入射角 θ を60度としたときの被照射物 (W) 2の表面形態を示し、(a) は200倍のSEM写真で、(b) は2000倍のSEM写真である。図36は入射角 θ を45度としたときの被照射物 (W) 2の

(b) は2000倍のSEM写真である。図37は入射角 θ を30度としたときの被照射物(W)2の表面形態を示し、(a) は200倍のSEM写真で、(b) は2006のSEM写真である。

表面形態を示し、(a)は200倍のSEM写真で、

【0035】(被照射物の融点と臨界入射角 $heta_c$ との関 係)上記実施例1~実施例5について、成膜した膜中の ドロップレットの平均混入密度が2×103 個/cm2 になるときの入射角 θ を臨界入射角 θ c として、各被照 射物の融点と臨界入射角 θ_c との関係を図38に示す。 図38より、概略的にみれば、被照射物の融点が高くな るほど、臨界入射角 θ_c が大きくなることがわかる。ま た、1000℃程度以上で2000℃程度未満の融点を もつ金属、例えばNi (融点1453℃)、Fe (融点 1536℃)、Cr(融点1875℃)を被照射物とし た場合は臨界入射角θcが30~35度程度となり、2 000℃程度以上で3500℃程度までの融点をもつ金 属、例えばM o (融点2610℃)、W (融点3410 $^{\circ}$ C)を被照射物とした場合は臨界入射角 $^{ extstyle heta}_{ extstyle heta}$ が $^{ extstyle heta}$ 3度程度となることがわかる。したがって、2000℃ 程度未満の融点をもつ金属を被照射物とした場合は、入 射角を30度以下にすることが特に好ましく、また20 00℃程度以上の融点をもつ金属を被照射物とした場合 は、入射角を35度以下にすることが特に好ましい。

【0036】(実施例6)本発明のレーザ成膜方法を用いて、Fe-Si-B膜よりなる磁歪式トルクセンサ用膜をトルク伝達軸に成膜した。なお、トルク伝達軸としてSCM400Hシャフト(Cr・Mo鋼シャフト、直径35mm)を用いた。上記レーザ成膜装置に図39に示す基材保持機構40を組付けた。この基材保持機構40は、基台41と、基台41に摺動可能に保持された基材保持部42と、基材保持部42に突設されトルク伝達軸30を回転可能に軸支する一対の保持板43と、基材

保持部42に付設され一対の保持板43に軸支されたトルク伝達軸30を回転させる第1モータ44と、基台41に摺動可能に保持されるとともに連結板45を介して基材保持部42と連結されたラック部46と、保持台41に固定されるとともにピニオン部47を介してラック部46を摺動させる第2モータ48とから構成されている。

【0037】そして、被照射物2として磁性金属(Fe75Si8B17、融点1146°C)を用い、第1モータ44及び第2モータ48を駆動させて、トルク伝達軸30を回転及びスライドさせながら、入射角 θ を30度として上記実施例1と同様の条件でレーザ成膜を行って、トルク伝達軸30の表面上に膜厚2 μ mの均一のトルクセンサ用膜300を成膜した。

【0038】また、比較のために、入射角 6 を 4 5 度とすること以外は上記と同様にトルク伝達軸 3 0 の表面上にトルクセンサ用膜 3 0 0 を成膜した。これらトルクセンサ用膜 3 0 0 が成膜されたトルク伝達軸 3 0 について、伝達トルクを検出した。これは、図 4 0 に示すように、トルクセンサ用膜 3 0 0 と非接触に U字型の励磁コイル5 3 に所定の電流(励磁電流:2 0 0 m A、励磁周である。このに対しておき、一150~150kgf・mのトルクを付加したときのトルクセンサ用膜 3 0 0 の近傍の磁界変化(電圧変化)を検出コイル5 4 で検出することにより行った。この結果を図 4 1 に示す。

【0039】図41からも明らかなように、入射角 θ を 45度としてトルクセンサ用膜300を成膜した比較例 に係るものはセンサ感度が2. 7mV/kgf・mだっ たのに対して、入射角 θ を30度としてトルクセンサ用 膜300を成膜した本実施例に係るもはセンサ感度が6 mV/kgf·mとなり、比較例に係るものより2倍以 上のセンサ感度を示した。これは、比較例に係るトルク センサ用膜300の膜中には粒径1~数10μmのドロ ップレットが存在するため、トルクセンサ用膜300と 検出用磁心52とのギャップを200μm程度とる必要 があったのに対し、本実施例に係るトルクセンサ用膜3 00はドロップレットがほとんどない緻密な膜であるた め、トルクセンサ用膜300と検出用磁心52とのギャ ップのずれを±1μm程度に抑えることができたからで ある。なお、入射角 θ を45度として成膜した比較例に 係るトルクセンサ用膜300はドロップレットの平均混 入密度が 1 × 1 0 5 個 / c m 2 だったのに対し、入射角 **θを30度として成膜本実施例に係るトルクセンサ用膜** 300はドロップレットの平均混入密度が2×103個 ノcm² だった。

【0040】また、付加トルクの最大値(F. S.)を 150kgf・mとしたときの、センサ感度の軸周上変 動を調べた。この軸周上変動は、トルクセンサ用膜30 0の周方向におけるセンサ感度の均一性を示すもので、 周上のポジションごとに出力電圧ートルク曲線を測定す ることにより求めた。この結果を図42に示す。図42 からも明らかなように、比較例に係るものはセンサ感度 の軸周上変動が4%F.S.程度だったのに対し、本実 施例に係るものは1%F.S.程度となり周方向に極め て均一なセンサ感度を有していることがわかる。

[0041]

【発明の効果】以上詳述したように本発明のレーザ成膜 方法は、レーザ光を照射する際の入射角を制御するとい う極めて簡単な手法により、被照射物からのドロップレットの発生を効果的に抑制して、ドロップレットの混入 量の少ない緻密な金属薄膜を成膜することができる。

【0042】このため、本発明のレーザ成膜方法により、磁気特性や導電特性に優れた磁性薄膜や電導体薄膜を成膜することが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本実施例に用いたレーザ成膜装置を概略的に示す模式図である。

【図2】実施例1に係り、入射角hetaを説明する模式図である。

【図3】実施例1に係り、入射角 θ と成膜したNi 薄膜中のドロップレットの平均混入密度との関係を示すグラフである。

【図4】実施例1に係り、入射角 θ を45度として成膜したNi 薄膜表面の粒子構造を示すもので、(a)は200倍のSEM写真、(b)は2000倍のSEM写真である。

【図5】実施例1に係り、入射角 θ を30度として成膜したNi 薄膜表面の粒子構造を示すもので、(a) は200倍のSEM写真、(b) は2000倍のSEM写真である。

【図6】実施例1に係り、入射角 θ を20度として成膜したNi 薄膜表面の粒子構造を示すもので、(a)は200倍のSEM写真、(b)は2000倍のSEM写真である。

【図7】実施例1に係り、入射角 θ を45度としてレーザ照射後の被照射物(Ni)の表面の粒子構造を示すもので、(a)は200倍のSEM写真、(b)は2000倍のSEM写真である。

【図8】実施例1に係り、入射角 θ を30度としてレーザ照射後の被照射物(Ni)の表面の粒子構造を示すもので、(a)は200倍のSEM写真、(b)は2000倍のSEM写真である。

【図9】実施例1に係り、入射角 θ を20度としてレーザ照射後の被照射物(Ni)の表面の粒子構造を示すもので、(a)は200倍のSEM写真、(b)は2000倍のSEM写真である。

【図10】実施例2に係り、入射角 &と成膜したFe 薄膜中のドロップレットの平均混入密度との関係を示すグ

ラフである。

【図11】実施例2に係り、入射角 θ を45度として成膜したFe薄膜表面の粒子構造を示すもので、(a)は200倍のSEM写真、(b)は2000倍のSEM写真である。

【図12】実施例2に係り、入射角 θ を30度として成膜したFe薄膜表面の粒子構造を示すもので、(a)は200倍のSEM写真である。

【図13】実施例2に係り、入射角 θ を20度として成膜したFe薄膜表面の粒子構造を示すもので、(a)は200倍のSEM写真である。

【図 1 4】 実施例 2 に係り、入射角 θ を 4 5 度としてレーザ照射後の被照射物(Fe)の表面の粒子構造を示すもので、(a)は 2 O O 倍の S E M 写真、(b)は 2 O O O 6 の S E M 写真である。

【図 1 5 】 実施例 2 に係り、入射角 θ を 3 0 度としてレーザ照射後の被照射物(Fe)の表面の粒子構造を示すもので、(a)は 2 0 0 倍の SEM 写真、(b)は 2 0 0 0 倍の SEM 写真である。

【図16】実施例2に係り、入射角 θ を20度としてレーザ照射後の被照射物(Fe)の表面の粒子構造を示すもので、(a)は200倍のSEM写真、(b)は200倍のSEM写真である。

【図17】実施例3に係り、入射角 θ と成膜したCr薄膜中のドロップレットの平均混入密度との関係を示すグラフである。

【図18】実施例3に係り、入射角 θ を45度として成膜したCr薄膜表面の粒子構造を示すもので、(a)は200倍のSEM写真である。

【図19】実施例3に係り、入射角 θ を30度として成膜したCr薄膜表面の粒子構造を示すもので、(a)は200倍のSEM写真、(b)は2000倍のSEM写真である。

【図20】実施例3に係り、入射角 θ を20度として成膜したCr薄膜表面の粒子構造を示すもので、(a)は200倍のSEM写真、(b)は2000倍のSEM写真である。

【図21】実施例3に係り、入射角 θ を45度としてレーザ照射後の被照射物(Cr)の表面の粒子構造を示すもので、(a)は200倍のSEM写真、(b)は200倍のSEM写真である。

【図22】実施例3に係り、入射角 θ を30度としてレーザ照射後の被照射物(Cr)の表面の粒子構造を示すもので、(a)は200倍のSEM写真、(b)は200倍のSEM写真である。

【図23】実施例3に係り、入射角 6 を20度としてレーザ照射後の被照射物 (Cr) の表面の粒子構造を示す

もので、(a) は200倍のSEM写真、(b) は20 00倍のSEM写真である。

【図24】実施例4に係り、入射角 θ と成膜したMo 薄膜中のドロップレットの平均混入密度との関係を示すグラフである。

【図25】 実施例4に係り、入射角 θ を60度として成膜したMo薄膜表面の粒子構造を示すもので、(a)は200倍のSEM写真である。

【図26】実施例4に係り、入射角 θ を45度として成膜したMo薄膜表面の粒子構造を示すもので、(a)は200倍のSEM写真である。

【図27】実施例4に係り、入射角θを30度として成膜したMo薄膜表面の粒子構造を示すもので、(a)は200倍のSEM写真、(b)は2000倍のSEM写真である。

【図28】 実施例4に係り、入射角 θ を60度としてレーザ照射後の被照射物(Mo)の表面の粒子構造を示すもので、(a)は200倍のSEM写真、(b)は200倍のSEM写真である。

【図29】実施例4に係り、入射角 θ を45度としてレーザ照射後の被照射物(Mo)の表面の粒子構造を示すもので、(a)は200倍のSEM写真、(b)は200倍のSEM写真である。

【図30】実施例4に係り、入射角 θ を30度としてレーザ照射後の被照射物(Mo)の表面の粒子構造を示すもので、(a)は200倍のSEM写真、(b)は200倍のSEM写真である。

【図31】実施例5に係り、入射角 θ と成膜したW薄膜中のドロップレットの平均混入密度との関係を示すグラフである。

【図32】実施例5に係り、入射角 θ を60度として成膜したW薄膜表面の粒子構造を示すもので、(a) は200倍のSEM写真、(b) は2000倍のSEM写真である。

【図33】実施例5に係り、入射角 θ を45度として成膜したW薄膜表面の粒子構造を示すもので、(a)は2

00倍のSEM写真、(b) は2000倍のSEM写真である。

【図34】実施例5に係り、入射角 θ を30度として成膜したW薄膜表面の粒子構造を示すもので、(a) は200倍のSEM写真、(b) は2000倍のSEM写真である。

【図35】 実施例5に係り、入射角 θ を60度としてレーザ照射後の被照射物(W)の表面の粒子構造を示すもので、(a)は200倍のSEM写真、(b)は2000倍のSEM写真である。

【図36】実施例5に係り、入射角 θ を45度としてレーザ照射後の被照射物(W)の表面の粒子構造を示すもので、(a)は200倍のSEM写真、(b)は2000倍のSEM写真である。

【図37】実施例5に係り、入射角 θ を30度としてレーザ照射後の被照射物(W)の表面の粒子構造を示すもので、(a)は200倍のSEM写真、(b)は2000倍のSEM写真である。

【図38】被照射物の融点と臨界入射角 θ_c との関係を示すグラフである。

【図39】実施例6に係り、磁歪式トルクセンサ用膜を トルク伝達軸に成膜する際に用いる基材保持機構を模式 的に示す斜視図である。

【図40】実施例6に係り、磁性金属膜が成膜されたトルク伝達軸について、伝達トルクを検出した方法を模式的に示す斜視図である。

【図41】実施例6に係り、入射角 θ を30度、45度として成膜したトルクセンサ膜について、伝達トルクを検出した結果を示すグラフである。

【図42】実施例6に係り、入射角 θ を30度、45度 として成膜したトルクセンサ膜について、センサ感度の 軸周上変動を測定した結果を示す棒グラフである。

【図43】Fe-Si-B膜におけるドロップレットの平均混入密度と膜密度との関係を示すグラフである。

【符号の説明】

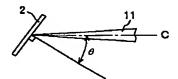
2…被照射物

5…基材

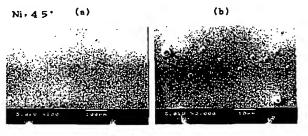
11…レーザ光

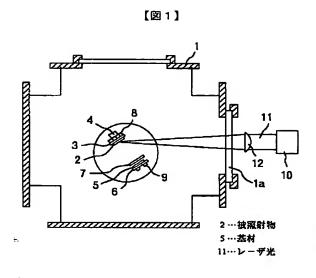
θ…入射角

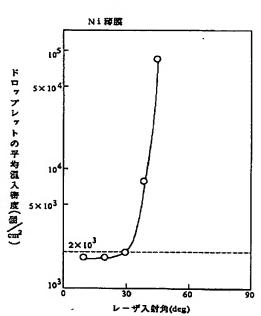
【図2】



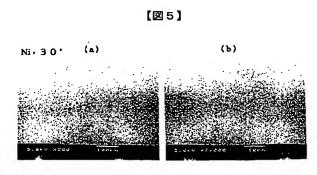
【図4】

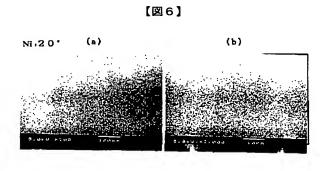


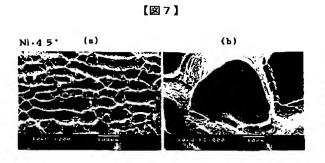


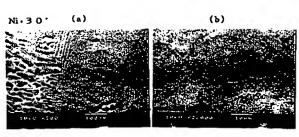


[図3]

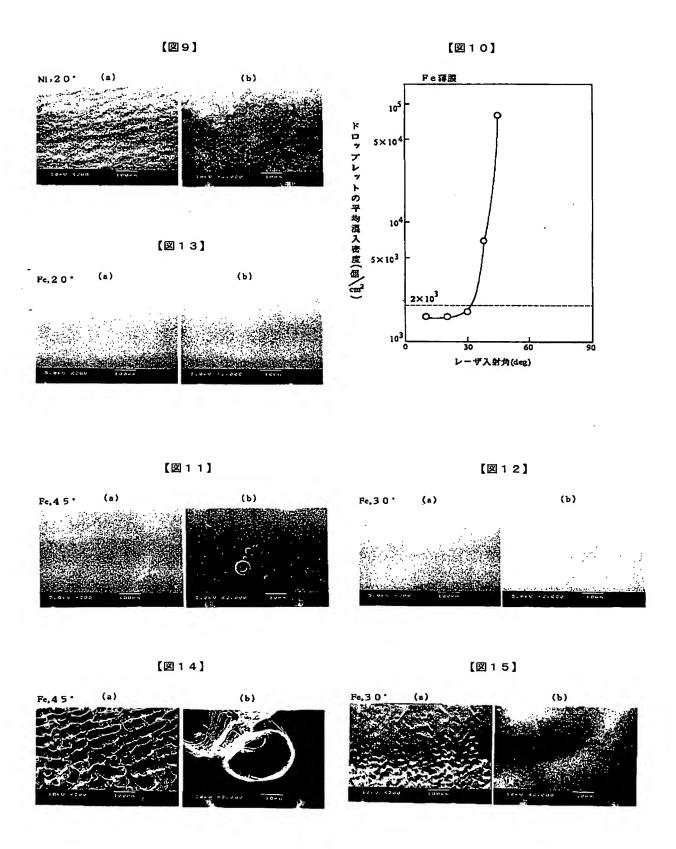


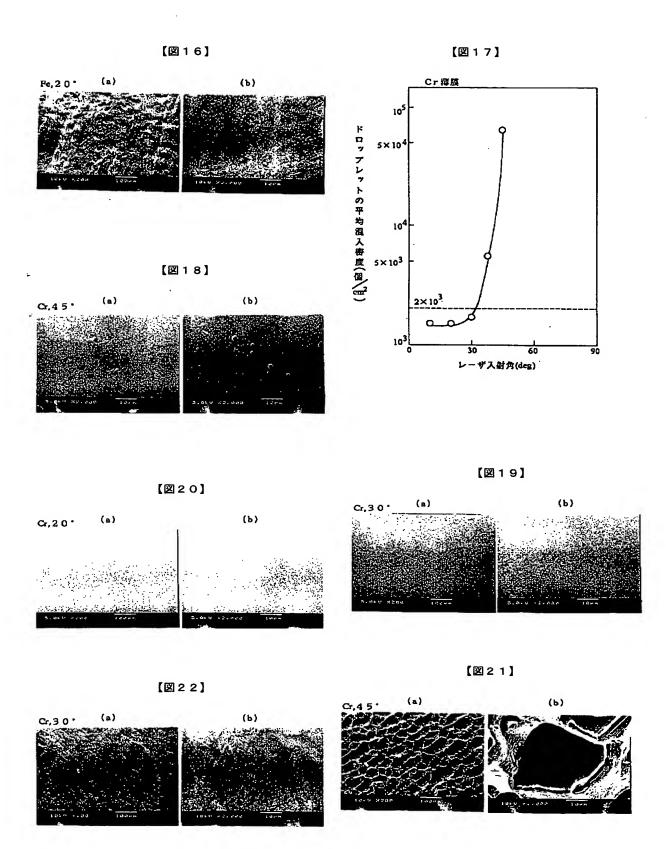


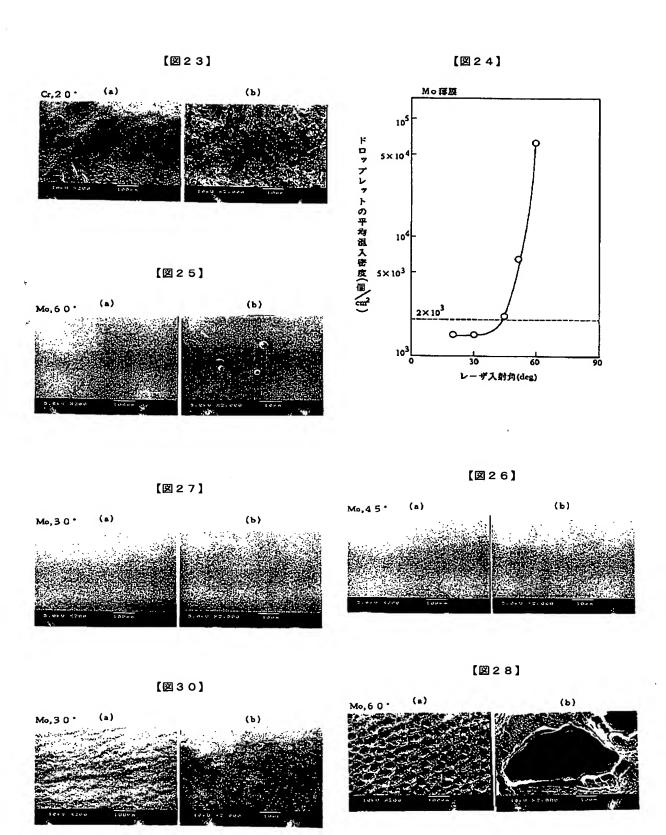


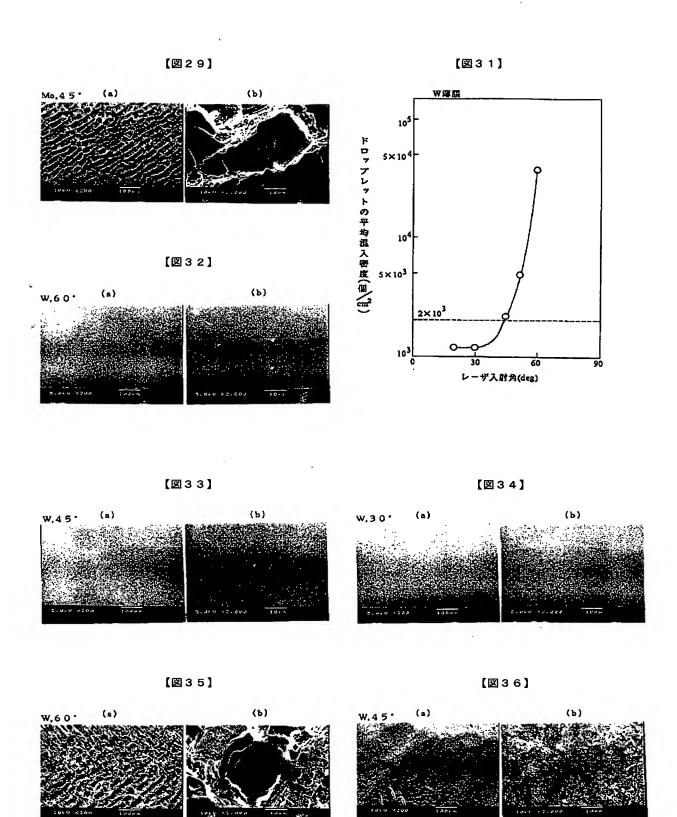


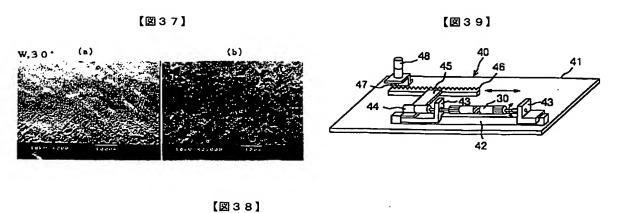
[図8]

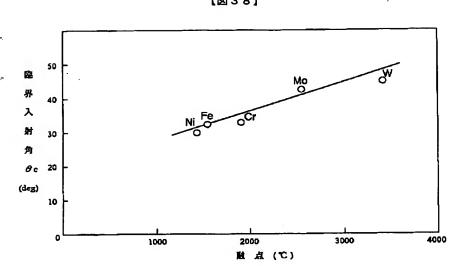


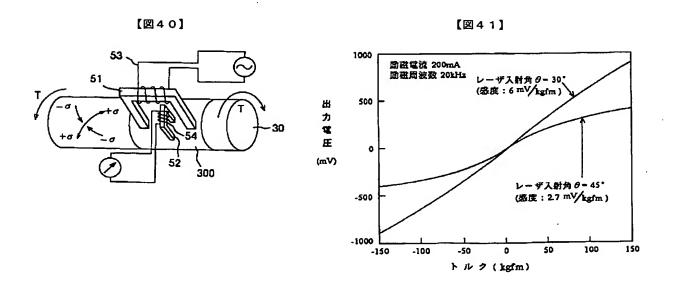




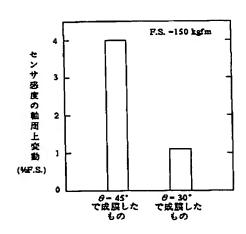




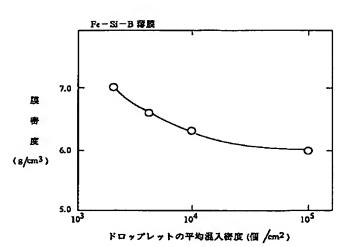








【図43】



フロントページの続き

(72)発明者 髙柳 登 愛知県豊田市トヨタ町1番地 トヨタ自動 車株式会社内

(72) 発明者 犬塚 浩之 愛知県刈谷市豊田町2丁目1番地 株式会 社豊田自動織機製作所内

(72)発明者 多賀 康訓 愛知県愛知郡長久手町大字長湫字横道41番 地の1 株式会社豊田中央研究所内 (72) 発明者 大脇 健史

愛知県愛知郡長久手町大字長湫字横道41番 地の1 株式会社豊田中央研究所内

(72)発明者 山寺 秀哉

愛知県愛知郡長久手町大字長湫字横道41番 地の1 株式会社豊田中央研究所内

(72) 発明者 秋浜 一弘

要知県愛知郡長久手町大字長湫字横道41番 地の1 株式会社豊田中央研究所内

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.